

# 托马斯芯片耐高温密封胶

产品名称	托马斯芯片耐高温密封胶
公司名称	成都托马斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:托马斯 型号:THO4062
公司地址	四川省成都市成华区驷马桥羊子山路68号东立国际广场B1区18楼1801室
联系电话	13308063272

## 产品详情

产品名称	托马斯芯片耐高温密封胶 ( tho4062 )
概述	本品系环氧树脂胶粘剂，单组份，加热快速固化，粘接强度高，耐高温性优良,结构性强、耐能强、使电子元件达到一个保密和密封的效果、是单位研发电子元件芯片最佳选择，操作
适用范围	适用于各种高温、水下或者是其他介质状态条件下工作的金属芯片、陶瓷复合芯片、复合cb)等芯片的自粘、封装与互粘，也适用于修复以及密封和保护电器、仪表的发热部件的密封以及芯片高温回流焊高强度作业。
性能特点	<ul style="list-style-type: none"><li>· 外观：为浅色或者深色粘稠液体，无固体机械颗粒。</li><li>· 固化速度快，100 时60分钟固化，完全冷却后1d即可达到最大粘接强度。</li><li>· 粘接强度高，耐久、耐紫外光性能优良。</li><li>· 耐高温性能好，适应温度范围广，粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。</li><li>· 粘接表面无需严格处理，使用方便。</li></ul>

<p>点</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 耐介质性能优良，耐油、水、酸、煤油、核辐射、乙二醇、碱以及油脂等。</li> <li>· 安全及毒性特征：有极轻微异味，无吸入危险，固化后实际无毒。</li> <li>· 贮存稳定性较好，贮存期为半年。</li> </ul> <p style="text-align: center;">主要技术性能指标如下：</p> <p style="text-align: center;">耐温范围:-45 - +400</p> <p style="text-align: center;">粘接强度:</p> <p>常温:拉伸强度 25mpa;剪切强度 21 . 6 mpa 150 :拉伸强度 2 . 75 - 4 . 65 mpa</p>
<p>使 用 方 法</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、将被粘物除锈、去污、擦净。</li> <li>3、将胶液涂于被粘物表面，合拢、压实、静置加热即可。</li> </ol>
<p>注 意 事 项</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、操作环境注意通风。</li> <li>2、胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗。</li> <li>3、未用完的胶应盖好，置于阴凉通风处。</li> </ol>